

株主・投資家の皆様へ 第76期中間報告書

平成23年4月1日 ▶ 平成23年9月30日

目次

ごあいさつ	1
製品別の売上概況	3
販売の状況	6
連結貸借対照表	7
連結損益計算書	8
連結キャッシュ・フロー計算書/個別業績の概要	9
トピックス	10
株式の状況/大株主の状況	12
株主還元/会社概要	13
役員および執行役員	14

Innovator in Electronics

muRata

株式会社 村田製作所

証券コード：6981

ごあいさつ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。第76期（平成24年3月期）の中間報告書をお届けするにあたり、当社グループの業績概要についてご報告申し上げます。

当第2四半期の業績について

当第2四半期連結累計期間の世界の経済情勢は、東日本大震災によるサプライチェーンの混乱が想定より早く治まったものの、米国の雇用・住宅市場の停滞、欧州財政危機の深刻化、新興国のインフレ懸念などから、景気の先行きに対する不透明感が強まってきました。当社が属するエレクトロニクス市場におきましては、スマートフォンやタブレット端末の生産が大幅に増加したことに加え、震災後の落ち込みから回復した自動車生産が堅調に推移しましたが、ノートパソコンや薄型テレビの生産は、前年同四半期連結累計期間を下回りました。

このような市場環境のもと、当社は、生産性改善や固定費抑制などのコストダウンを推進するとともに、中期的な目標である海外生産の拡大に向けて、平成23年4月に中国・無錫の新工場棟でチップ積層セラミックコンデンサの増産体制を確立し、5月にタイ・チェンマイでノイズ対策部品の新工場棟を増設しました。また、7月には中国・深圳の新工場棟で近距離無線通信モジュールの

増産体制を確立しました。

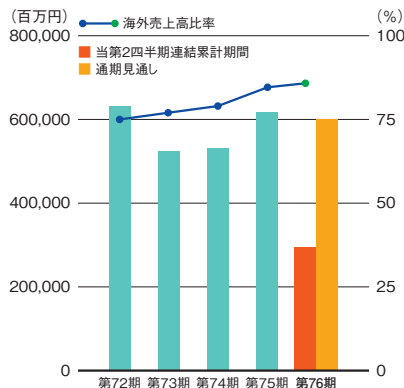
これらの結果、当社の当第2四半期連結累計期間の業績は、以下のとおりとなりました。

売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ6.1%減の295,906百万円となりました。利益につきましては、製品価格の値下がりや円高の進行（前年同四半期連結累計期間に比べ対米ドルの平均レートで9円14銭の円高）といった減益要因を、コストダウンによる原価低減で補うことができず、営業利益は前年同四半期連結累計期間比32.9%減の31,024百万円、税引前四半期純利益は同26.8%減の34,719百万円、四半期純利益は同23.8%減の23,669百万円となりました。

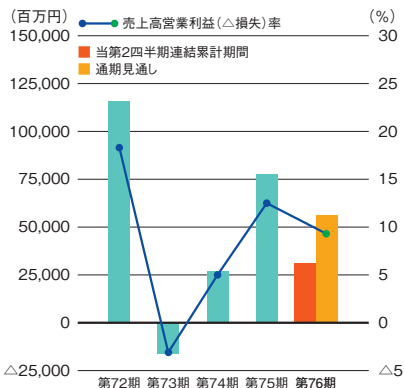
通期業績の見通し

当下半期の世界の経済情勢につきましては、先進国の景気低迷、欧州の金融不安に加え、比較的好調であった新興国の成長率が鈍化する可能性が高まり、景気の先行きは非常に不透明であります。当社が属するエレクトロニクス市場におきましては、円高の継続、タイの洪水によるサプライチェーンへの影響などの懸念材料もあり、当下半期の業績に対して、当初の想定より厳しい見方が必要となってきました。その結果、売上高は600,000百万円（前連結会計年度比2.9%減）、営業利益は56,000

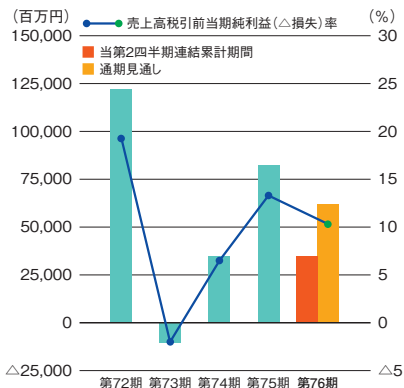
■売上高 / 海外売上高比率



■営業利益(△損失) / 売上高営業利益(△損失)率



■税引前当期純利益(△損失) / 売上高税引前当期純利益(△損失)率



百万円（同27.7%減）、税引前当期純利益は62,000百万円（同24.4%減）、当期純利益は42,000百万円（同21.5%減）を見込んでおります。

なお、設備投資につきましては、来年度以降も新興国需要の拡大や電子機器の高機能化に伴う部品搭載点数の増加が期待できることから、電子部品需要の拡大に対応していくため、70,000百万円を計画しております。

株主還元策について

株主の皆様への利益還元策としては、配当による成果の配分を優先的に考え、長期的な企業価値の拡大と企業体質の強化を図りながら、1株当たり利益を増加させることにより配当の安定的な増加に努めることを基本方針としております。この方針に基づき、連結ベースでの業績と配当性向並びに内部留保の蓄積などを総合的に勘案したうえで、配当による利益還元を行っております。

また、当社は資本効率の改善を目的に自己株式の取得を適宜実施しており、平成23年10月31日開催の取締役会において、平成23年11月2日から12月22日までの期間に15,000百万円、4,000千株をそれぞれ上限に自己株式を取得することを決議いたしました。

中間配当金は、当上半期の業績だけではなく内部留保の蓄積を鑑み、期初に予定していたとおり、1株当たり

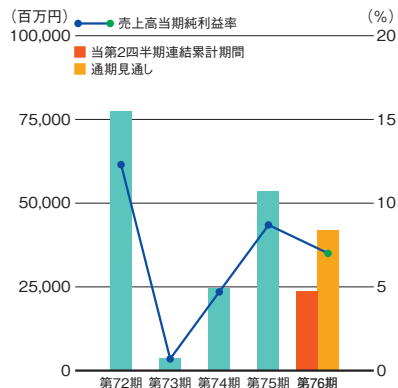
50円とさせていただきます。また、当期末配当金につきましても、中間配当金と同様の1株当たり50円とし、年間配当金は100円を予定しております。なお、この1株当たり配当金は、現時点の事業環境及び通期の業績見通しによるものです。

(注)業績予想の前提条件及び注意事項については当社第2四半期決算短信6、7ページをご参照ください。第2四半期決算短信は当社ホームページでもご覧いただけます。

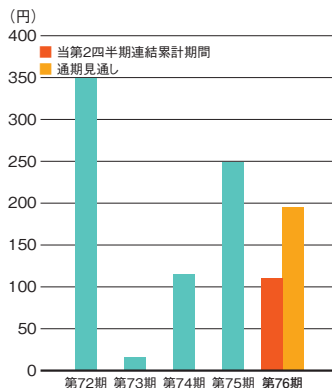


代表取締役社長 村田恒夫

■当期純利益 / 売上高当期純利益率

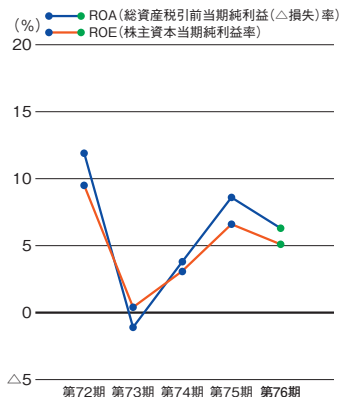


■1株当たり当期純利益



■ROA / ROE

※第76期は当第2四半期連結累計期間の確定値を示しています。



製品別の売上概況

当第2四半期連結累計期間の製品別の売上高を前年同四半期連結累計期間と比較した概況は、以下のとおりであります。

コンポーネント

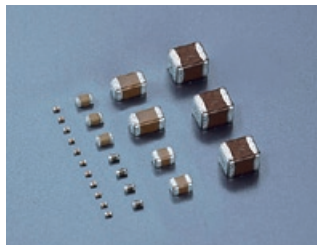
当第2四半期連結累計期間のコンポーネントの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ6.2%減の206,861百万円となりました。

コンデンサ

この区分には、積層セラミックコンデンサなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、主力のチップ積層セラミックコンデンサが、携帯電話、カーエレクトロニクス向けは、数量の増加と小型・大容量化の進展による品種構成の良化により好調でしたが、AV機器向けが振るわず、全体では若干の減少となりました。

その結果、コンデンサの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ3.7%減の109,899百万円となりました。



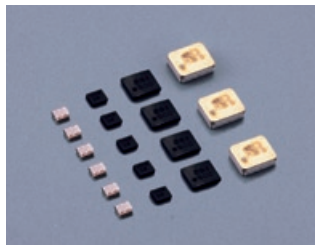
チップ積層セラミックコンデンサ

圧電製品

この区分には、表面波フィルタ、セラミック発振子、圧電センサ、セラミックフィルタなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、表面波フィルタが、携帯電話の生産台数の増加とマルチバンド化に伴う携帯電話1台当たりの搭載点数の増加により、数量では大幅な増加となりましたが、値下がりや円高の影響から、金額では振るいませんでした。セラミック発振子は、コンピュータ及び関連機器やAV機器向けなどで低迷しました。圧電センサは、ハードディスクドライブの衝撃検知用センサ、バックソナー用の超音波センサともに低調でした。

その結果、圧電製品の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ14.0%減の39,567百万円となりました。



表面波フィルタ

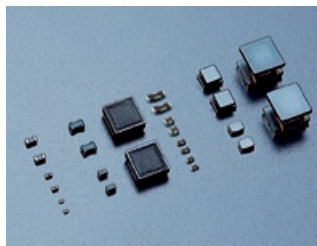
コンポーネント

その他コンポーネント

この区分には、EMI除去フィルタ、コイル、サージスタ、コネクタ、センサなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、EMI除去フィルタが、コンピュータ及び関連機器向けは堅調に推移しましたが、AV機器向けで大きく落ち込み、前年同四半期連結累計期間を下回りました。コイルは、AV機器、カーエレクトロニクス向けは減少しましたが、コンピュータ及び関連機器向けが伸び、全体では堅調でした。コネクタは、タブレット端末向けを中心に大幅に伸長しました。

その結果、その他コンポーネントの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ4.9%減の57,395百万円となりました。



チップフェライトビーズ／
チップコモンモードチョークコイル／
エミフィル[®]／チップコイル

モジュール

当第2四半期連結累計期間のモジュールの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ5.9%減の87,856百万円となりました。

通信モジュール

この区分には、近距離無線通信モジュール、多層デバイス、回路モジュールなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、近距離無線通信モジュールが、携帯メディアプレイヤー、車載向けは大きな減少となりましたが、スマートフォン、タブレット端末向けが大幅に増加し、全体では好調でした。多層デバイスは、通信機器向けで落ち込みました。

その結果、通信モジュールの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ5.2%減の62,494百万円となりました。



無線LAN向けモジュール
(Wi-Fiモジュール)

製品別の売上概況

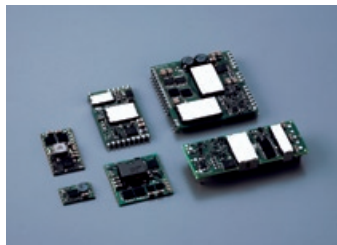
モジュール

電源他モジュール

この区分には、電源などが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、電源がAV機器、カーエレクトロニクス向けは好調でしたが、その他の用途で振るいませんでした。

その結果、電源他モジュールの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ7.5%減の25,362百万円となりました。



DC-DCコンバータ

用語解説

■コンデンサ（P1、P3）

コンデンサは電気を蓄える働きをし、電源の電圧変動を吸収して電子機器の安定動作に貢献する役割を担う部品です。携帯電話、パソコン、デジタル家電など、さまざまな電子機器に使われています。

■フィルタ（表面波/セラミック/EMI除去）（P3、P4）

コーヒーのフィルタでイメージできるように、必要な信号だけを通し、不要な信号は通さない働きをします。表面波フィルタ、セラミックフィルタは特定の信号だけを通す役割をし、EMI除去フィルタは信号に含まれるノイズ（EMI = Electromagnetic Interference）を除去します。

■セラミック発振子（P3）

電子機器にはプロセッサやマイコンなどのデジタルICが多数使われていますが、デジタル信号処理を正しく動作させるためには、その「テンポ」を制御する「基準クロック信号」というものが必要です。セラミック発振子は、圧電セラミックスの圧電現象（電圧を加えると伸縮し、物理的な力を加えると電圧を発生する）を利用し、基準クロック信号を発生させる電子部品です。

■サーミスタ（P4）

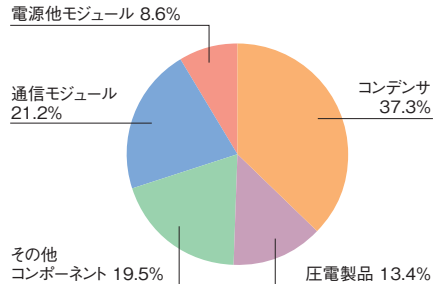
サーミスタとは、温度により抵抗値が変化するセラミックの抵抗体です。電子機器の小型化・高出力化が年々進む中、機器の機能だけでなく、機器の安全性・安定性対策にサーミスタ機能のニーズが高まっており、過熱検知・過電流保護・温度補償などの用途に展開されています。

■多層デバイス（P4）

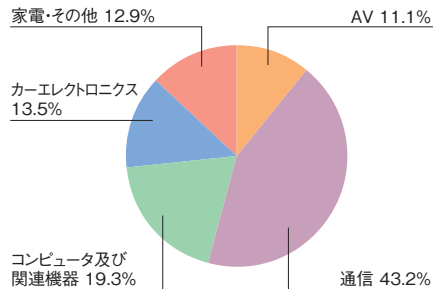
従来は1枚の基板上に多数の部品を実装して構成していた回路を、セラミックシートを何層も重ねて形成した多層セラミックスの内部に3次元で回路を構成し、部品の機能を作り込むことによって、小型化を実現した電子部品です。

販売の状況

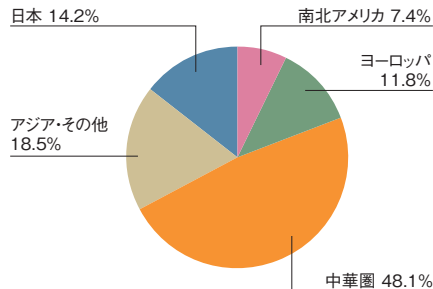
製品別売上高



用途別売上高 (当社推計値に基づいております)



地域別売上高



(単位:百万円)

期 別 項 目	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日 ～平成22年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日 ～平成23年9月30日)	構成比 (%)	増 減	
					増減額	増減率 (%)
コンデンサ	114,172	36.4	109,899	37.3	△4,273	△3.7
圧電製品	46,017	14.7	39,567	13.4	△6,450	△14.0
その他コンポーネント	60,335	19.2	57,395	19.5	△2,940	△4.9
コンポーネント計	220,524	70.3	206,861	70.2	△13,663	△6.2
通信モジュール	65,898	21.0	62,494	21.2	△3,404	△5.2
電源他モジュール	27,427	8.7	25,362	8.6	△2,065	△7.5
モジュール計	93,325	29.7	87,856	29.8	△5,469	△5.9
製品売上高計	313,849	100.0	294,717	100.0	△19,132	△6.1

(単位:百万円)

期 別 項 目	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日 ～平成22年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日 ～平成23年9月30日)	構成比 (%)	増 減	
					増減額	増減率 (%)
AV	42,934	13.7	32,572	11.1	△10,362	△24.1
通信	132,529	42.2	127,393	43.2	△5,136	△3.9
コンピュータ及び関連機器	59,527	19.0	56,902	19.3	△2,625	△4.4
カーエレクトロニクス	39,482	12.6	39,843	13.5	361	0.9
家電・その他	39,377	12.5	38,007	12.9	△1,370	△3.5
製品売上高計	313,849	100.0	294,717	100.0	△19,132	△6.1

(単位:百万円)

期 別 項 目	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日 ～平成22年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日 ～平成23年9月30日)	構成比 (%)	増 減	
					増減額	増減率 (%)
南北アメリカ	25,082	8.0	21,887	7.4	△3,195	△12.7
ヨーロッパ	35,517	11.3	34,871	11.8	△646	△1.8
中華圏	150,276	47.9	141,626	48.1	△8,650	△5.8
アジア・その他	53,992	17.2	54,567	18.5	575	1.1
海外計	264,867	84.4	252,951	85.8	△11,916	△4.5
日本	48,982	15.6	41,766	14.2	△7,216	△14.7
製品売上高計	313,849	100.0	294,717	100.0	△19,132	△6.1

連結貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	前連結会計年度末		当第2四半期 連結会計期間末	
	(平成23年3月31日)		(平成23年9月30日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)	(988,508)	(100.0)	(978,810)	(100.0)
流動資産	412,233	41.7	419,098	42.8
現金及び預金	48,880		55,860	
短期投資	35,445		24,091	
②有価証券	66,121		64,471	
受取手形	1,447		1,301	
売掛金	122,852		123,150	
貸倒引当金	△996		△847	
たな卸資産	110,450		122,752	
繰延税金資産	19,743		19,379	
前払費用及びその他の流動資産	8,291		8,941	
有形固定資産	283,988	28.7	289,359	29.6
土地	44,125		44,501	
建物及び構築物	274,188		276,832	
機械装置及び工具器具備品	586,831		601,374	
建設仮勘定	22,607		21,913	
減価償却累計額	△643,763		△655,261	
投資及びその他の資産	292,287	29.6	270,353	27.6
関連会社に対する投資	—		3,217	
②投資	244,609		221,460	
繰延税金資産	9,680		10,838	
その他の固定資産	37,998		34,838	
合 計	988,508	100.0	978,810	100.0

(単位:百万円)

期 別 科 目	前連結会計年度末		当第2四半期 連結会計期間末	
	(平成23年3月31日)		(平成23年9月30日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)	(167,364)	(16.9)	(159,065)	(16.3)
流動負債	110,589	11.2	100,166	10.3
短期借入金	7,841		10,441	
買掛金	33,598		35,204	
未払給与及び賞与	22,663		22,344	
①未払税金	24,623		8,980	
未払費用及びその他の流動負債	21,864		23,197	
固定負債	56,775	5.7	58,899	6.0
長期債務	1,047		3,656	
退職給付引当金	53,755		54,034	
繰延税金負債	767		305	
その他の固定負債	1,206		904	
(資本の部)	(821,144)	(83.1)	(819,745)	(83.7)
資本金	69,377		69,377	
資本剰余金	102,396		102,396	
利益剰余金	733,862		746,799	
その他の包括損失累計額	△36,432		△50,766	
有価証券未実現損益	2,535		△451	
年金負債調整勘定	△422		△489	
デリバティブ未実現損益	△34		△46	
為替換算調整勘定	△38,511		△49,780	
自己株式(取得原価)	△48,059		△48,061	
合 計	988,508	100.0	978,810	100.0

Point

前連結会計年度末からの主な増減要因

①「未払税金」(△15,643百万円)の減少

主に法人税等の減少によるものです。

②「有価証券」(△1,650百万円)及び「投資」(△23,149百万円)の減少

主に債券の償還があったことによるものです。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別		前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)	
			金 額	百分比	金 額	百分比
				%		%
売 上 高			314,989	100.0	295,906	100.0
売 上 原 価			206,019	65.4	203,351	68.7
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			42,465	13.5	41,494	14.0
研 究 開 発 費			20,249	6.4	20,037	6.8
営 業 利 益			46,256	14.7	31,024	10.5
受 取 利 息 及 び 配 当 金			1,995	0.6	2,592	0.8
支 払 利 息			△20	△0.0	△34	△0.0
為 替 差 損 益			△896	△0.3	966	0.3
そ の 他 (純 額)			127	0.1	171	0.1
税 引 前 四 半 期 純 利 益			47,462	15.1	34,719	11.7
法 人 税 等			16,396	5.2	12,468	4.2
(法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税)			(17,405)		(11,138)	
(法 人 税 等 調 整 額)			(△1,009)		(1,330)	
持 分 法 投 資 利 益			—	—	1,418	0.5
四 半 期 純 利 益			31,066	9.9	23,669	8.0

Point

スマートフォンやタブレット端末の生産が大幅に増加したことに加え、震災後の落ち込みから回復した自動車生産が堅調に推移しましたが、ノートパソコンや薄型テレビの生産が減少した結果、売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ6.1%減の295,906百万円となりました。営業利益につきましては、製品価格の値下がりや円高の進行といった減益要因を、コストダウンによる原価低減で補うことができず、前年同四半期連結累計期間比32.9%減の31,024百万円となりました。税引前四半期純利益は同26.8%減の34,719百万円、四半期純利益は同23.8%減の23,669百万円となりました。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
		(平成22年4月1日～平成22年9月30日)	(平成23年4月1日～平成23年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		47,794	17,851
投資活動によるキャッシュ・フロー		△79,079	△8,523
財務活動によるキャッシュ・フロー		△7,378	△4,912
換算レート変動による影響		△1,878	△1,212
現金及び現金同等物の増加(△減少)額		△40,541	3,204
現金及び現金同等物の期首残高		108,777	63,020
現金及び現金同等物の四半期末残高		68,236	66,224

個別業績の概要

(単位:百万円)

科 目	期 別	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間
		(平成22年4月1日～平成22年9月30日)	(平成23年4月1日～平成23年9月30日)
売上高		277,351	255,001
営業利益		10,349	3,751
経常利益		16,521	11,518
四半期純利益		13,162	10,504
総資産		617,477	611,231
純資産		404,746	402,273
1株当たり四半期純利益(円)		61.33	48.94

世界初!! 電界結合方式 ワイヤレス電力伝送モジュールの量産開始

スマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器は頻繁に充電する必要がある、置くだけで充電できるワイヤレス充電のニーズが増えています。当社は、電界結合方式*ワイヤレス電力伝送モジュールを開発し、8月より量産を開始しました。当モジュールは高い伝送効率を実現しており、10Wのワイヤレス電力伝送が可能です。日立マクセル株式会社のワイヤレス充電セット「エアボルテージ for iPad2」にも採用されました。

* 電界結合方式：送電側と受電側に電極を設置し、電極間に発生する電界を利用してエネルギーを伝送する方法



世界初!! HiQタイプ積層セラミック コンデンサ0402サイズの商品化

小型モバイル機器の高機能化を背景に部品搭載数が増加する一方、実装面積の小型化が求められています。パワーアンプ*¹等に採用されているHiQ*²タイプ積層セラミックコンデンサは、従来、0603サイズ（0.6×0.3mm）が最小でしたが、今回世界最小となる0402サイズ（0.4×0.2mm）を商品化しました。このコンデンサは、実装面積の削減やセット機器の低背化、低消費電力化、新包装形態W4P1*³テーピングによる工程歩留まり向上などに貢献します。9月より量産を開始しています。

*1 パワーアンプ（Power Amplifier）：携帯電話などにおいて高周波信号を送信する際に同信号を増幅させる半導体

*2 HiQ：材料の見直しにより、一般的な積層セラミックコンデンサに比べ、VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で、高いQ値*を有する

（※Q値：DF [Dissipation Factor] 損失比率の逆数で、数値が大きいほどロスが少ない）

*3 W4P1：テープ幅4mm、部品ピッチ1mmのプラスチックテーピング



世界初!! 高透明度有機圧電フィルムを用いた センサデバイスの開発

当社では、学校法人関西大学と三井化学株式会社との共同研究で開発した「高透明度有機圧電フィルム」を応用したセンサデバイスを開発しました。このフィルムは（1）圧電出力定数*¹が大きい、（2）透明度が高い、（3）焦電性*²を持たない、（4）曲げだけでなくねじりを検出できる、というユニークな特徴を持ちます。応用デバイスとして、曲げやねじりで直感的に操作する新感覚のコントローラ「リーフグリップリモコン」と、指の動きだけでなく押圧力（どれだけ強く押したか）も検知でき、押し方の強弱で画像の拡大・縮小の速度を変えることができるタッチパッド「タッチプレッシャーパッド」を参考品として開発しました。今後、様々なインターフェースへの応用が期待されます。

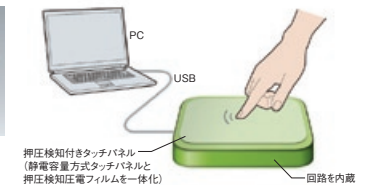
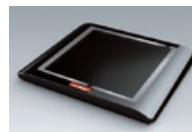
*1 圧電出力定数：圧電歪定数を誘電率で除した値で、センサの感度の指標として用いられる。この定数が大きいほど感度はよい

*2 焦電性：温度変化によって誘電体の表面電荷が変化すること

リーフグリップリモコン（サンプル）



タッチプレッシャーパッド（サンプル）



フィリピン生産子会社の設立

2011年9月、フィリピンに新たな生産子会社『PHILIPPINE MANUFACTURING CO. OF MURATA, INC.』を設立しました。近年、電子機器の高機能化やスマートフォン・タブレット端末など新たなアプリケーションの普及・伸長により電子部品の需要は拡大していくと見込み、より一層高まる供給責任を果たすため、海外生産の拡大や生産拠点の拡充を検討してきました。このたび、豊富で定着率の高い労働力の確保、アセアン等新興国市場を見据えた立地という観点より、フィリピンに生産子会社を設立しました。2013年1月より、まずチップ積層セラミックコンデンサの生産を開始し、続けて他の製品の生産も予定しています。

事業買収・譲受

2011年10月、VTI Technologies Oy（本社：フィンランド、以下「VTI社」）の全発行済株式を、当社の完全子会社Murata Electronics Europe B.V.（本社：オランダ）が取得することについて、VTI社の全ての株式保有者との間で株式売買契約を締結しました。この買収は、法令等に基づく許認可の取得 および その他株式売買契約に定める諸条件の確認を行ったうえで、2012年4月末までに完了する予定です。VTI社はMEMS*1技術を基盤とするセンサメーカーで、独自の3D MEMS テクノロジーを使った自動車産業向け、医療機器向けシリコンベースの容量センサの開発および製造を行っています。今回の買収によって、当社のセンサ事業の強化・拡大につながるものと考えています。

また、2011年10月、ルネサス エレクトロニクス株式会社よりパワーアンプ事業を譲り受けることで最終契約を締結しました。携帯電話市場において、スマートフォンの需要拡大や低価格化等を背景に、通信機能構成部品について送受信機能一体化の要求が増加しています。当社は受信側のフロントエンドモジュール*2で世界トップレベルのシェアを保持していますが、今回の事業譲受によって、送信側であるパワーアンプ製品との複合化を進め、さらなる事業拡大を図っていきます。

*1 MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）：微小電子機械システムとも呼ばれる半導体集積回路の微細な加工技術

*2 フロントエンドモジュール（Front End Module）：携帯電話などにおいて、アンテナに接続する高周波信号の経路選択、信号のフィルタリングなどを行う

株式の状況

平成23年 9月30日現在

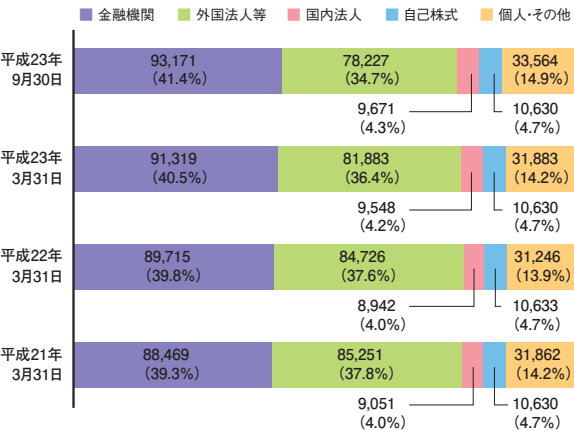
株式事項

発行済株式総数 225,263千株
株主数 81,796名

株式上場

[国内]
東京証券取引所 市場第一部
大阪証券取引所 市場第一部
[海外]
シンガポール証券取引所

所有者別分布状況(千株)



大株主の状況

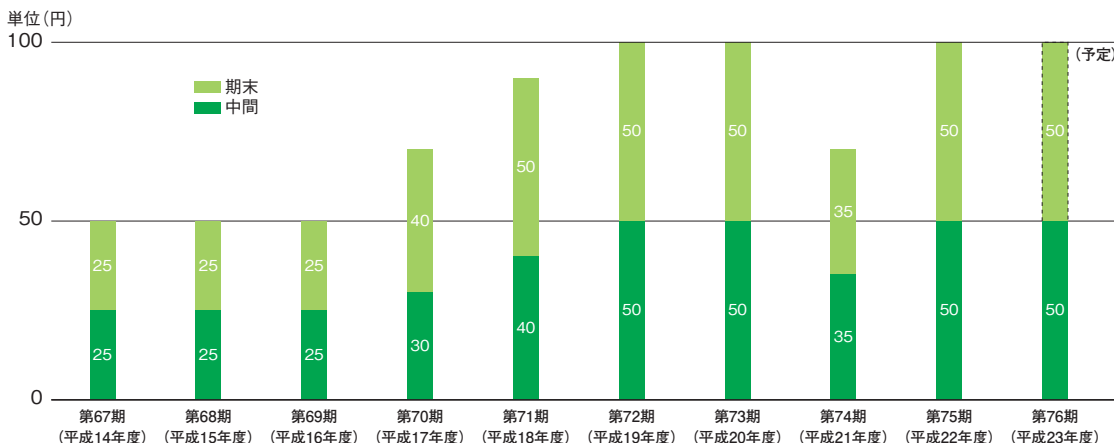
平成23年 9月30日現在

順位	株主名	持株数(千株)	出資比率(%)
1	ジェーピー モルガン チェース バンク 3 8 0 0 5 5	13,441	6.3
2	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	12,549	5.8
3	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	10,019	4.7
4	日本生命保険相互会社	9,201	4.3
5	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	7,265	3.4
6	株式会社京都銀行	5,260	2.5
7	明治安田生命保険相互会社	5,240	2.4
8	SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS	4,274	2.0
9	株式会社滋賀銀行	3,551	1.7
10	三井住友海上火災保険株式会社	3,015	1.4

(注) 出資比率は、発行済株式の総数から自己株式(10,630千株)を除いて計算しております。

株 主 還 元

■ 1株当たり配当金の推移



■ 自己株式の取得

当社は資本効率の改善を目的に自己株式の取得を適宜実施しており、平成14年～平成20年の7年間で152,857百万円、29,716千株の自己株式を取得し、これまでに19,000千株を消却しました。

また、平成23年10月31日開催の取締役会において、平成23年11月2日から12月22日までの期間に15,000百万円、4,000千株をそれぞれ上限に自己株式を取得することを決議しました。

会 社 概 要

平成23年9月30日現在

■ 商 号 株式会社 村田製作所

Murata Manufacturing Co., Ltd.

■ 設 立 昭和25年12月23日 (創業 昭和19年10月)

■ 資 本 金 69,377百万円

■ 従業員数 連結 35,937名 個別 6,960名

■ 所 在 地 本 社 〒617-8555京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 電話 075-951-9111

支 社 東京支社・東京都渋谷区

事業所 長岡事業所・京都府長岡京市/八日市事業所・滋賀県東近江市/野洲事業所・滋賀県野洲市/横浜事業所・横浜市緑区

営業所 仙台/さいたま/東京/立川/浜松/名古屋/安曇野/京都/神戸/岡山/福岡 ほか

■ 国内関係会社 22社

■ 海外関係会社 44社

代表取締役

取締役社長	村田 恒夫
取締役副社長	藤田 能孝

取締役

村田 恒夫
藤田 能孝
家木 英治
牧野 孝次
棚橋 康郎 (社外取締役)
吉原 寛章 (社外取締役)

監査役

常勤監査役	中山 素彦
	吉野 幸夫
監査役	平岡 哲也 (社外監査役)
	山田 英暉 (社外監査役)
	豊田 正和 (社外監査役)

執行役員

専務執行役員	後呂 眞次
上席常務執行役員	井上 純
常務執行役員	家木 英治
	坂本 秀夫
	牧野 孝次
	山内 公則
執行役員	鷹木 洋
	西村 昌雄
	濱地 幸生
	小島 祐一
	井上 亨
	山岡 修
	間所 新一
	岡田 剛和
	中島 規巨
	蘭田 聡
	岩坪 浩

株 主 メ モ

■ 事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

■ 剰余金の配当基準日

中間配当金 9月30日

期末配当金 3月31日

■ 単元株式数

100株

■ 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社

事務取扱場所

大阪市北区曽根崎二丁目11番16号

みずほ信託銀行株式会社 大阪支店証券代行部

郵便物送付／電話お問い合わせ先

〒168-8507

東京都杉並区和泉二丁目8番4号

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

☎0120-288-324

■ 公告の方法

当社ウェブサイトに掲載いたします。

(<http://www.murata.co.jp/>)

ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。



〔表紙写真〕

オーストリア リンツを走る
ムラタセイサク君®

株 式 事 務 に 関 す る ご 案 内

証券会社でお取引をされている株主様

お 手 続 き

お問い合わせ先

お取引のある証券会社

お 手 続 き 内 容

住所変更、名義変更、単元未満株式の
買取請求、配当金受取り方法のご指
定、相続に伴うお手続き等

特別口座に記録されている株主様

お 手 続 き

お問い合わせ先

＜特別口座の管理機関＞

左記の株主名簿管理人(みずほ信託
銀行株式会社証券代行部)

＜お取扱店＞

みずほ信託銀行株式会社

本店および全国各支店

みずほインベスターズ証券株式会社

本店および全国各支店

お 手 続 き 内 容

住所変更、名義変更、単元未満株式の
買取請求、配当金受取り方法のご指
定、相続に伴うお手続き等

特 別 口 座 で の

留 意 事 項

特別口座では、株式の売却はできま
せん。売却するには、証券会社にお取
引きの口座を開設し株式の振替手続
きが必要となります。

※未払配当金のお支払いにつきましては、両株主様ともに
上記のお取扱店に加え、株式会社みずほ銀行 本店および
全国各支店で承ります。

※当社では単元未満株式の買取に関する手数料を無料とし
ておりますので、ぜひご利用ください。(お取引証券会社
等で株式を管理している場合は、お取引証券会社等で別
途手数料のかかる場合がございます。)



Innovator in Electronics

muRata

株式会社 村田製作所